

NEWS RELEASE

これまで培ってきた幅広いスパッタリング技術を自由に組み合わせ可能な新しい半導体・電子部品製造装置シリーズが誕生
市場やユーザーからのさまざまなニーズに応えつつ、高い生産性と短納期での提供を両立

半導体デバイス・電子部品の配線層や機能膜などを形成する幅広い用途の成膜工程に対応した装置シリーズ“Adastra”が誕生します。



Adastra では、キヤノンアネルバが長年にわたり数多くのデバイス向けに提供してきた成膜技術を統一されたプラットフォームに集約しました。プロセスモジュールを自由に選択できる構成を採用することで多様なニーズに柔軟に対応できます。また従来機種と比較して、装置のフットプリントや消費エネルギーを大幅に改善し、生産性に優れ、より高い付加価値を提供します。

メモリー/センサー/ロジック分野で
培った技術力



半導体メモリー



半導体ロジック



高周波フィルター



ハードディスク



磁気センサー



イメージセンサー

最先端成膜技術をすべて統合
次世代成膜プラットフォーム



Adastra

■ 成膜技術の融合・柔軟な装置構成

半導体デバイスや電子部品の多様化にともない、製造工程も複雑化しています。

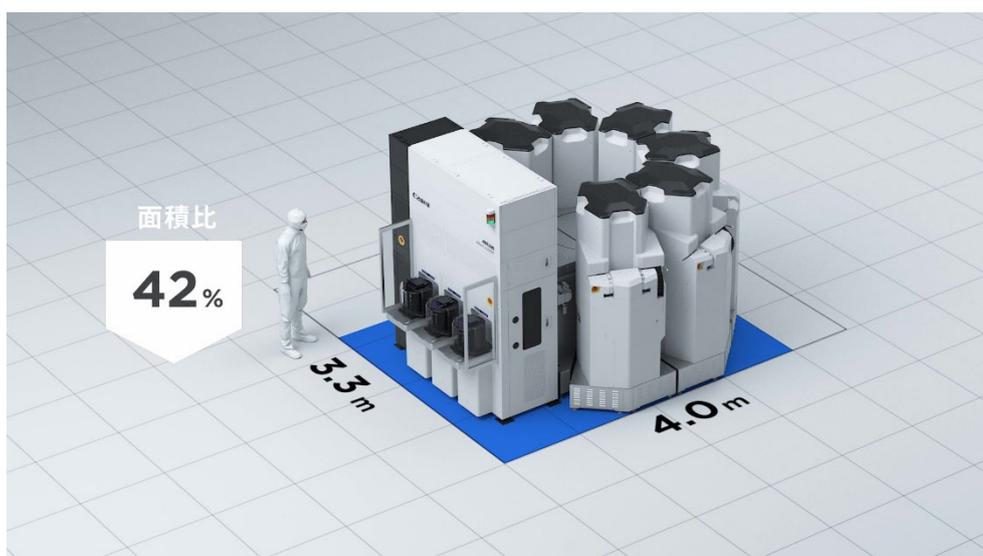
Adastra は半導体・電子部品向けプロセスモジュールを自由に選択できる構成を採用しました。

装置構成は、研究開発から量産まで各フェーズに合わせて柔軟に選択・変更が可能であり、研究開発でのプロセスをそのまま量産へ移行できます。

■ 省スペース

従来機と比較し、モジュールを小型化することで、フットプリントを 42%減少することができました。

階下においても、制御系ラックや排気系ポンプなどを削減し、同様の省スペース化を実現しています。



■ ユーザビリティ

人間工学に基づきシールド交換などのメンテナンスの作業性が向上しました。

メンテナンス後の装置セットアップを自動で行なうことができます。さらに装置の稼働状況をわかりやすく表示し情報をリアルタイムでモニタリングすることで、予知保全をサポートします。

■ 環境への配慮

小型化により使用材料を 7%削減し、輸送エネルギーを 8%削減しました。

また、冷却機構を大幅に見直し、市水使用量を 55%削減、エネルギー由来の CO₂ 排出量を 18%削減しました。

キヤノンアネルバはこれからも半導体・電子部品産業の発展に貢献していきます。